

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

MÍSTO KONÁNÍ:

Střední škola informatiky, Čichnova 23, 624 00 Brno

SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystrc, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystrc, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou – od brněnského výstaviště směr Bystrc (přehrada), před prodejnou OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnou OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SŠ informatiky, poštovníctví a finančnictví, s možností parkování.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete **poštou** spolu se závazným požadavkem na stravu, nejpozději do **18. 10. 2013** na adresu:

SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno

fax: 00420-546 211 009

případně e-mail: smtinfo@nextra.cz do 20. 10. 2013

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme**. Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

Ubytování na Střední škole informatiky

Čichnova 23, Brno-Komín

Telefonické objednávky: p. Hanáková, p. Kneslová
00420-541 123 364

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu.

Stravování: oběd v areálu SŠ informatiky á 70,- Kč

Prezence:

22. 10. 2013 8.15–8.30 hod.

Účastnický poplatek včetně občerstvení a bulletinu

(úhrada při prezenci)

400,- Kč

SMT-INFO KONSORCIUM

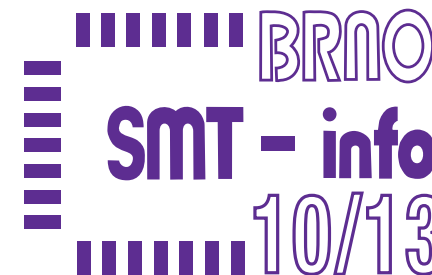
ve spolupráci s

FEKT VUT v Brně

a

SŠ INFORMATIKY BRNO

Vás zvou
na mezinárodní konferenci



PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

ČIŠTĚNÍ DPS

NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

BRNO 22. října 2013
SŠ informatiky
Čichnova 23, Brno-Komín

kód akce 10/13

602 00 BRNO
Údolní 53
SMT-INFO konsorcium
Czech Republic

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem.
- V přílehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními:

ACC SILICONES	LŮKON THERMAL SOLUTIONS
ADOPT SMT EUROPE	PAN ELECTRONICS
AMTECH	VÚB
DCT CZECH	ULBRICH HYDROAUTOMATIK
LASERJOB	

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

TĚMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKCÍ POŘADANÝCH SMT-INFO:

SMT-INFO 02/2014 11. únor 2014

Místo konání: SŠ informatiky, Čichnova 23, Brno

- NÁVRHOVÉ SYSTÉMY DPS
- KOMPLEXNÍ VÝROBNÍ LINKY
MODERNÍCH MONTÁŽÍ
- INSPEKČNÍ SYSTÉMY

ODBORNÝ GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM, Údolní 53, 602 00 Brno

tel.: 00420-541 146 113

fax: 00420-546 211 009

mobil: 00420-602 542 966

e-mail: smtinfo@nexta.cz

PROGRAM KONFERENCE

Úterý – 22. října 2013

- 8.15 - Prezence
8.30 - Zahájení konference
8.40 - Možnosti spolupráce FEKT VUT s průmyslem v oblasti montážních technologií /J. Šandera, J. Starý, FEKT VUT Brno/
8.50 - Požadavky na pájené elektronické sestavy - IPC:2010, IEC:2013 a ČSN:2013-09-16 /K. Jurák, Praha, Z. Nejezchlebová, ÚNMZ Praha/
9.10 - Nové bezolovnaté slitiny /C. Hoppenbrouwers, ALPHA (an Alent plc Company) Europe, M. Cichra, ERMEG Liberec/
10.10 - Káva, občerstvení
10.30 - Progresivní řešení šablon pro komplexní DPS /A. Axmann, LASERJOB, Furstafeldbruck/
11.10 - Nová generace pájecí pasty SHENMAO /J. Jánošík, AMTECH Brno/
11.30 - Redukované požadavky na podlahovou plochu u tepelných procesů >20 min. (vytvrzování, sušení aj.) /P. Heilmann, LŮKON THERMAL SOLUTIONS, Täuffelen/
11.50 - Diskuse
12.00 - Selektivní pájecí vlny od firmy ATF /M. Abel, ABE.TEC Pardubice/
12.20 - ESD oděvy CleverTex® /M. Zubec, VÚB Ústí nad Orlicí/
12.40 - Sázka na inovace se vyplácí. Příčiny úspěchů strojů ERSA /M. Duda, PBT Rožnov p. Radh./
13.00 - Oběd
13.40 - Vývoj v oblasti čištění DPS, ROSE tester 32 /D. Joura, DCT Czech, Černá Hora/
14.00 - Nové materiály pro rychle vytvrzované VOC-free krytí DPS /R. Příkryl, ACC SILICONES Brno/
14.20 - Můžete čistit šablony a zapájené sestavy společně v jedné myčce? /M. Šaffer, PBT Rožnov p. Radhoštěm/
14.40 - Pájecí pasty HERAEUS s prodlouženou životností na šabloně /M. Galajda, SMT SERVICE Košice/
14.55 - Integrál teplota/čas (Heating Factor) a kvalita pájeného spoje /J. Starý, FEKT VUT Brno, M. Dosedla, FEI Brno, Z. Jurčík, Honeywell Brno/
15.10 - Diskuse a zakončení konference
15.30 - Káva, občerstvení

Přednášky v angličtině a němčině budou tlumočeny.

Změny programu vyhrazeny.

Závazná přihláška na konferenci

PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

ČIŠTĚNÍ DPS

NOVINKY V MIKROELEKTRONICE

22. října 2013

Jméno, příjmení, titul

Název a adresa podniku (PSČ)

funkce v zaměstnání

telefon fax

e-mail

Stravování – oběd: 22. října 2013 **ano-ne**

.....
podpis účastníka

.....
razítko a podpis
organizace

ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2014

02/14 Návrhové systémy DPS. Komplex.výrob.linky **ano-ne**

04/14 Výroba DPS. Materiály pro montáž. technologie **ano-ne**

10/14 Pájení a tepelné procesy. Čištění DPS, Trendy **ano-ne**

Jméno, příjmení, titul

Název a adresa podniku (PSČ)